

Xiaomi готовит к релизу новый фирменный процессор XRING 02, который выйдет в 2026 году. В отличие от конкурентов, переходящих на 2-нм техпроцесс, компания останется на 3-нм архитектуре TSMC.

По слухам, чип будет производиться по усовершенствованной технологии N3P — третьему поколению 3-нм техпроцесса тайваньского гиганта. Основные причины такого решения — высокая стоимость 2-нм пластин (около \$30 000 за штуку) и ограничения на доступ к современным EDA-инструментам для китайских производителей из-за экспортного контроля США.

В результате Xiaomi решила сбалансировать затраты и стабильность производства. Первым смартфоном с XRING 02 должен стать Xiaomi 16S Pro. Но компания рассматривает использование процессора не только в мобильных устройствах, но и в планшетах, а также в автомобильных системах.